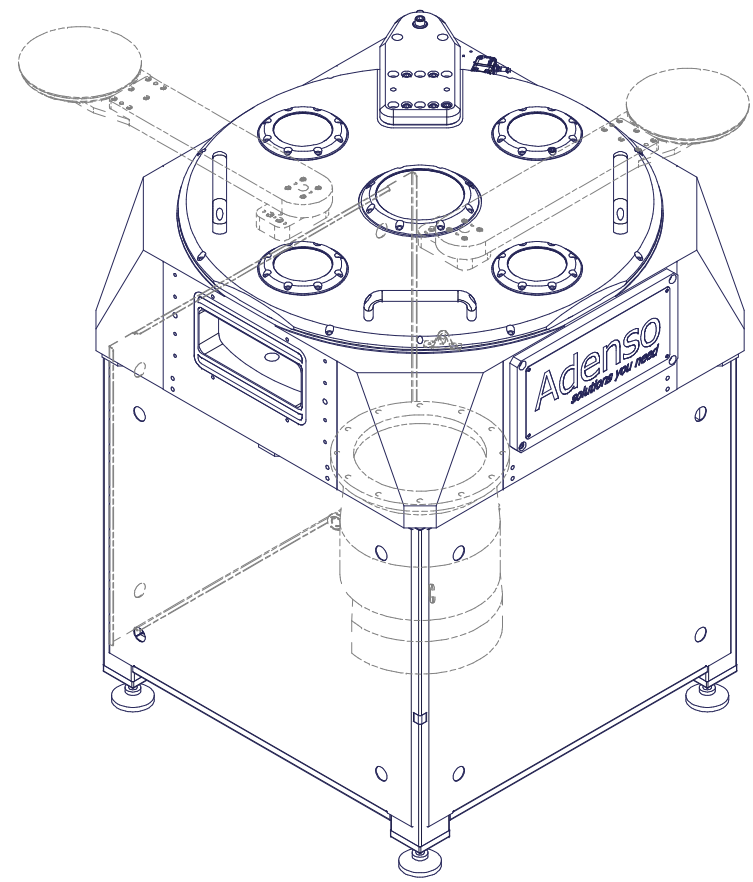
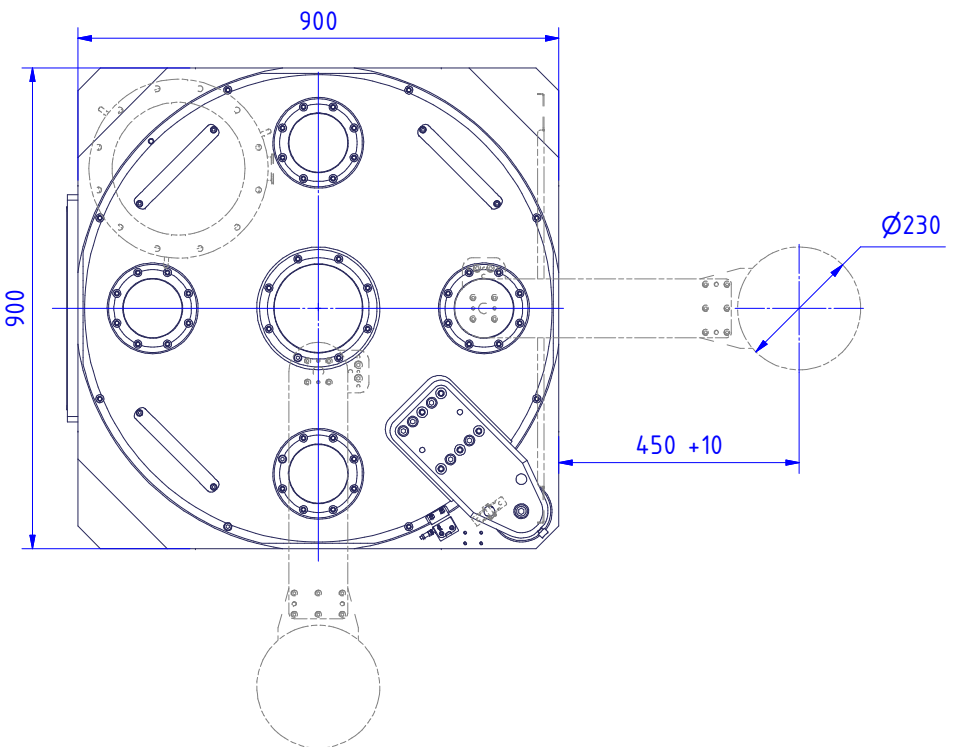
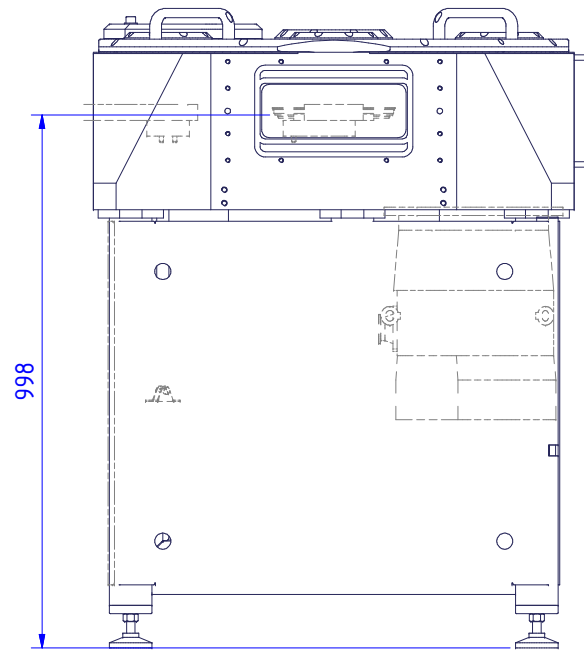
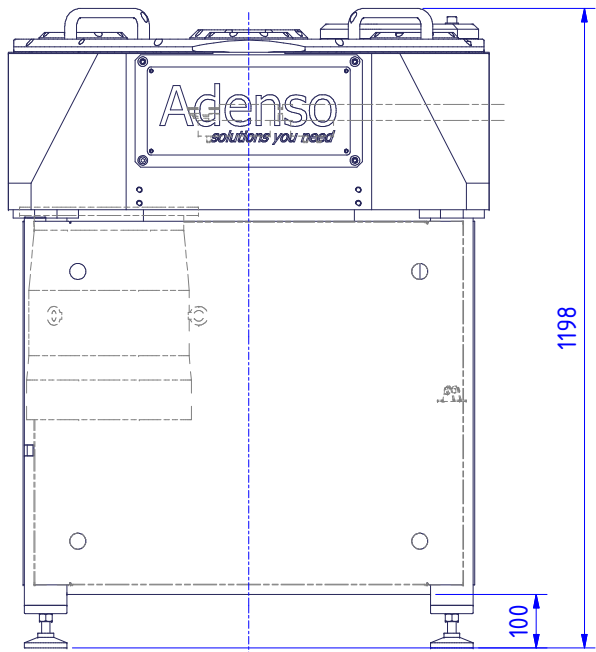


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Trägers vorbehalten.  
 Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority.  
 Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.



[www.waferhandling.solutions](http://www.waferhandling.solutions)

Positionstoleranz / tolerances of location		Kanten mit unbestimmter Form nach DIN ISO 13715		Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 Längen und Winkelmaß m Form und Lage K Allg.-Tol. Schweißkonst. nach DIN ISO 2768 Längen und Winkelmaß B Form und Lage F		Prüfmaße nach DIN 406-T1 Tolerierungsgrundsatz nach ISO 8015 Bewertungsgruppe für Unregelmäßigkeiten (Schweißverbindung) c DIN EN ISO 5817	
∅	Bohrungen / holes	0,1 mm				Maßstab: 1 : 5 Halbzeug:	
∅	Gewinde / threads	0,1 mm				Masse: - Material/Oberfläche:	
∅	Passungen / fits	0,01 mm					
projection ISO 128 - method 1		Oberflächenbeschaffenheit nach DIN EN ISO 1302 Vakuum-Dichtflächen keine Rillen und Riefen quer zum Dichtungsverlauf zulässig		Dichtfläche Rz 6,3			
			Datum	Name	Benennung		
	Gezeichnet		29.04.2014	BC	Wafer Handling Module		
	Freigabe				wafer handling module		
01	Benennung angep.	26.06.2014	EM	Zeichnungsnr.		Revision	1 / 1
Status		Änderungen		Datum		Name	
188-230099-99.idw		Ersatz für:		Ersatz durch:		A3	

Kopie kann vom Maßstab abweichen. Copy may be not to scale.